

株主の皆さまへ

証券コード 6740

2019年9月11日

東京都港区西新橋三丁目7番1号

株式会社ジャパンディスプレイ

代表取締役社長 月崎 義幸

当社の事業概況と臨時株主総会における議決権行使のお願いについて

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社臨時株主総会（以下「本総会」）の招集ご通知を発送するにあたり、当社の事業概況につき株主の皆様へご説明させて頂くとともに、本総会における議決権の行使につきお願いさせて頂きたく存じます。

当社は、前年度に当たる2018年度下期において狭額縁液晶ディスプレイであるFULL ACTIVE™の大幅需要増を見込んでおりました。しかしながら、中国における景気減速やスマートフォンのライフサイクルの長期化等が要因と見られるスマートフォン市場の不振により、2018年11月以降、FULL ACTIVE™を中心とするディスプレイ需要は当社の当初想定を大幅に下回りました。そのため当社は、当初2018年度の最終利益の黒字化を目標としておりましたものの、誠に遺憾ながら、2018年度も赤字を計上することとなりました。前年度の業績に関し、株主の皆様からのご期待に沿うことができず、当社経営陣を代表し、心からお詫び申し上げます。

また、2019年度においても当社を取り巻く事業環境は改善しておらず、当社は人員削減を含む構造改革を進めている最中ですが、今年度も厳しい状況が続くことが見込まれます。

上記状況の下、当社の資金繰り及び収益性が急激に悪化していることから、今回招集ご通知を送付させて頂きました本総会にお諮りする議案の審議は、当社にとり非常に重要な意味を有しております。つきましては、株主の皆様におかれましては、本総会における議案をご確認の上、議決権を行使頂きたくお願い申し上げます。なお、本総会において必要な議案が承認されなかった場合には、当社は持続的な事業運営に不可欠な長期安定資金を得ることができず、また今後の資金繰りが悪化することで事業継続が困難となる可能性がありますことを以下にご説明申し上げます。

当社は、有機EL（以下「OLED」）ディスプレイの量産化技術の確立と事業化の加速を目的とした戦略的パートナーシップの構築を目指すべく、当社の筆頭株主である株式会社INCJ（以下「INCJ」）とも協議をしながら、複数の戦略的パートナー候補先との間で協議を進めてまいりました。しかしながら、事業環境の急激な変化に伴い、当社の資金繰り及び収益性が急激に悪化したため、当社としては、悪化した資金繰りの抜本的な解決や上場会社として適切な純資産額水準の確保のためには、大規模な資本金が早期に必要であると判断し、候補先の中から、最終的なスポンサーを決定すること

としました。その結果、当社は本年4月12日に、Suwaコンソーシアムを当社のスポンサーとして選定することを決定し、①Suwa Investment Holdings, LLC (以下「Suwa (注)」) との「CAPITAL AND BUSINESS ALLIANCE AGREEMENT」(資本業務提携契約)、②Harvest Tech Investment Management Co., Ltd. (以下「Harvest Tech」) との蒸着方式OLEDディスプレイの量産計画に関する業務提携の策定及び実行に向けた「Memorandum of Understanding」(OLED業務提携基本合意)等を締結いたしました。その後、Suwaの出資予定者の構成に変更が生じたこと等から、本年8月7日に、③Suwaとの間で「AMENDED AND RESTATED CAPITAL AND BUSINESS ALLIANCE AGREEMENT」(資本業務提携変更契約)を締結しております。

資本業務提携変更契約に基づき、当社は、Suwaに対して、第三者割当による当社普通株式、株式会社ジャパンディスプレイ第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「本第2回CB」)及び株式会社ジャパンディスプレイ第3回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「本第3回CB」)の発行(以下「本第三者割当」)を実行して資金繰りの抜本的な解決と安定的な事業継続を目的とした純資産の確保を図るとともに、Harvest TechとのOLED業務提携基本合意に基づき、蒸着方式OLEDディスプレイの量産計画の策定及び実行に向けて協議を推進してまいります。加えて、INCJとの間でも既存の負債性資金の一部を資本性資金に変更する新規借入及びINCJに対する第三者割当による優先株式(以下「本優先株式」)の発行によるリファイナンスを行うことで合意しております。

なお、本第三者割当の実行には、本総会における本第三者割当の実行及び本優先株式の発行に関連する議案、並びに発行可能株式総数の増加及び本優先株式の発行のための定款の一部変更に係る議案の承認がなされ、その他の条件等がすべて満たされる必要があります。

本総会においてお諮りする本第三者割当に係る当社普通株式の払込金額並びに本第2回CB及び本第3回CBに付された新株予約権の行使価額は、直近の市場株価から大幅なディスカウントとなり、また本第三者割当により大規模な株式の希薄化を伴うため、既存の株主様には重大な影響を与えることとなりますことを大変重く受け止めております。一方、本第三者割当及びリファイナンスにより健全な財務基盤を確保し、中長期的な事業成長により企業価値向上の実現を図ることは、株主の皆様にとって最善の策であると考えており、この点につきご理解賜りたく重ねてお願い申し上げます。

敬 具

(注) Suwaは本第三者割当のために設立された会社であり、北京に本社を持ち中国最大の資産運用会社グループの一つであるHarvestグループに属するプライベートエクイティ投資を行う運用会社であるHarvest Techが組成するファンド(詳細は未定)が本第三者割当の実行までにSuwaの出資者となる予定です。また、Suwaの新たな出資予定候補者である香港の投資会社であるOasis Management Company Ltd.が運用又は助言するファンドについて、今後、反社会的勢力と何らかの関係を有していないことや、払込みに要する資金等の状況等を確認の上、新たなSuwaの出資予定者に追加する予定です。

● 議決権行使につき判断頂く上でご参照頂きたい事項

▶ Suwa及びHarvest Techとの間の契約の概要

本年4月12日にSuwaとの間で、本第三者割当の実行によりSuwaから最大800億円の資金を調達する（※1）旨の資本業務提携契約を締結（本年8月7日にSuwaの出資予定者変更等に伴い資本業務提携変更契約を締結）するとともに、中長期的な成長を目指しHarvest Techとの間でOLED業務提携基本合意を締結しております。

（調達金額800億円の内訳）

- ① 普通株式の発行：420億円
- ② 本第2回CBの発行：80億円（※2）
- ③ 本第3回CBの発行：300億円（※2）（資金需要に応じて）

▶ INCJからのサポート

INCJとの間で以下のサポートを受けることについて合意しております。

- ① INCJから500億円の新規借入及び1,020億円の本優先株式の発行による総額1,520億円の支援を受け、これを原資に既存の負債性資金である既存債務の一部を資本性資金に変更するリファイナンスを行う
- ② 本年4月以降、INCJから、本第三者割当の払込みまでの資金需要に対するブリッジ・ローン及び短期借入金の提供を受ける
- ③ 当社のINCJに対する債務（借入金等）及び当社の債務（コミットメントライン）に対するINCJによる連帯保証に関し、Suwaへの本第三者割当が実行された場合に発動するチェンジ・オブ・コントロール（CoC）条項が付されているが、本第三者割当が実行された場合でも、INCJは当該CoC条項を行使しない
- ④ 上記②のブリッジ・ローンの内200億円分及び既存の劣後特約付借入の一部（計463億2,000万円）の代物弁済として、当社が保有する株式会社JOLED株式をINCJに譲渡する

※1 本第三者割当は、本第三者割当の実行に際して必要とされる各国の関係当局の許認可等が得られること、当社の株主総会において、本第三者割当の実行及びINCJに対する本優先株式の発行に関連する議案、発行可能株式総数の増加及び本優先株式の発行のための定款の一部変更に係る議案並びにSuwaが指名する取締役の選任議案が承認されること、その他の条件等がすべて満たされることを条件としています。なお、本第3回CBについては、上記のほか、当社がSuwaに対して、本第3回CBの発行に係る払込資金は不要であるとして所定の方法により事前の書面による通知を行っていないこと及びSuwaによる本第3回CBの発行に係る払込みに要する資金の調達が完了していること等を条件としています。

2 当社は、本年8月27日付の当社取締役会において、本総会における本第三者割当に係る議案として、本第2回CBの発行価額の総額を100億円を上限として増額させ、本第3回CBの発行価額の総額を100億円を上限として減額させること（ただし、本第2回CB及び本第3回CBの発行価額の総額を合計380億円とする。）等の決定を取締役に委任することを併せて付議する旨の決議を行っており、当社取締役会決議により、本第2回CBの発行価額の総額である80億円が100億円を上限として増額され、本第3回CBの発行価額の総額である300億円が100億円を上限として減額される可能性があります。

▶ 本第三者割当の実行により得た資金の使途

Suwaへの本第三者割当の実行により調達する予定の資金（最大800億円）の使途は次のとおりです。

- ・ 運転資金（一部をINCJからのブリッジ・ローンの弁済に充当）：380億円
- ・ 成長事業における研究開発費用：約92億円
- ・ 成長事業における設備投資：320億円
- ・ 発行諸費用：約8億円

- ▶ 本第三者割当における当社普通株式の発行価額（1株当たり50円）の算出根拠
当社は、当初Suwaコンソーシアム（Suwaの設立元である共同体）から提案を受けた1株あたり47円という発行価額に関し、交渉当時の当社の市場株価から大幅なディスカウントとなり当社の既存の株主の皆様と与える影響が大きいこと等から、発行価額についてSuwaコンソーシアムとの間で繰り返し交渉を行ってきました。しかしながら、Suwaコンソーシアムは、当社に対し1株当たり50円とすることまでしか譲歩することができない旨を主張しました。当社としては、当社の置かれた現在の状況に鑑み、Suwaコンソーシアムからの資金提供を確保することが当社及び当社株主の皆様にとって最善の策であると考えられること、Suwaとの間で真摯な協議及び交渉を経た結果として最終的に合意されたものであることに加え、第三者算定機関から株式価値算定書及びフェアネス・オピニオンを取得した結果、1株当たり50円という払込金額は、妥当な金額であると判断しました。
- ▶ 本第三者割当以外に望ましい資金調達方法はなかったのか
公募増資を含む様々な資金調達手法について比較検討を行いました。当社が希望する時間軸での必要金額の調達及び上場会社として適切な純資産額水準の確保が確実に見込まれることが最も重要な考慮要素であると考え、それを実現できる最良の選択肢として、第三者割当の方法を選択しました。
- ▶ 本総会で本第三者割当に関連する議案が否決された場合はどうなるのか
万が一、本第三者割当に関連する議案が否決された場合には、具体的な状況を踏まえて適時・適切に対応することを想定しておりますが、本第三者割当による資金調達が実現しなかった場合、当社の資金繰りが悪化し、事業継続が困難となる可能性があります。
当社として現時点で採り得る選択肢を十分に比較検討した結果、当社としては、本総会ですべての議案をご承認頂き、本第三者割当による資金調達を実現することが、既存の株主様を含むすべてのステークホルダーにとって最善であると考えております。
- ▶ 本第三者割当による資金調達はいつ実施する予定か
当社普通株式及び本第2回CBの発行による500億円（※2）の資金調達については、本第三者割当の実行の前提条件が充足されることを条件に、本年10月31日、若しくは前提条件の充足後5営業日以内のいずれか遅い方の日、又は当社とSuwaの間で別途合意した日に実施することを合意しております。なお、本第三者割当の払込期間（払込期日）は本年8月29日から2020年8月28日まで（のいずれかの日）としておりますが、本第3回CBを発行する場合には、2019年度内に発行することを想定しております。
- ▶ OLED業務提携基本合意に基づく業務提携の内容は
Harvest Techとの業務提携は、当社の技術力とHarvest Techの資金調達力を合わせ、OLEDディスプレイの設計、製造及び販売におけるリーディングカンパニーとなることを目的としたものです。当社は、スマートフォン向けディスプレイ市場における液晶ディスプレイからOLEDディスプレイへの置換が進む状況に鑑みると、蒸着方式OLEDディスプレイの量産計画の策定及び実行に向けた協議の推進は、当社の中長期的な成長の実現のためには極めて重要であると考えております。そこで、当社及びHarvest Techは当該量産計画の策定及び実行に向けて協議を推進していくことについて合意したものです。